

# *Business Report*

第36期 中間株主通信  
平成19年4月1日～平成19年9月30日

**株式会社 精工技研**



代表取締役社長 上野 昌利

## 技術の研鑽と未知の領域への果敢な挑戦により「精密加工」「光学」の進化を支えてまいります。

株主の皆様には、平素より格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

当社は1972年の創業以来、精密加工技術をコアテクノロジーに成長を続け、現在は「精機」「光製品」の2つを核として事業を展開しております。

精機事業では、CD、DVDなど光ディスクの成形用金型を製造し、世界のトップシェアを獲得してまいりました。これらの新規需要が一巡した現在、次世代光ディスク（HD DVD、ブルーレイ・ディスク）市場の立ち上がりに期待を寄せているところです。

光製品事業では、積極的なM&Aを展開し、製品ラインアップと海外販路の拡大を進めております。また、M&Aによるシナジー効果を発揮させた新製品の市場投入を進め、今後も製品面と営業面の双方を強化してまいります。

さらに、企業としての成長を持続させるため、当社のコア技術を活かせる「精密加工」「光学」の分野において社会に貢献する新たな事業の開拓を積極的に進めてまいります。

当社は「品質・精度・性能でお客様にお応えする」という理念を基本に、他社に真似のできない高度な技術によってお客様に安心と信頼を与える製品づくりを行い、企業価値の向上と優位性の確保を図ってまいりたいと考えております。

株主の皆様におかれましても、今後とも一層のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### CONTENTS

- P01 Top Message [ごあいさつ]
- P02 Review of Operation [当中間期の業績]
- P03-05 Our New Business [精工技研のオンラインワン技術・新商品の紹介]
- P06 Topics [トピックス]
- P07-08 Financial Statements [財務諸表(要旨)]
- P09 Stock Information [株式情報]
- P10 Corporate Data [会社情報]

### 経営成績

当社グループが営む事業の関連分野においては、デジタル家電や携帯機器等の消費拡大が継続いたしました。しかしながら、需要の拡大に反比例する形で価格の下落圧力が増し、業界内での競争は一層激化することとなりました。

こうした経営環境のもとで当社グループは、将来にわたって安定的な企業成長を実現し、より幅広い事業領域において社会の進歩発展に貢献することができる企業グループとなるための基盤づくりに注力いたしました。これまで同様、技術の向上や事業拡大に向けた投資を行い、半導体産業への参入、これから活躍が期待される光コネクタや各種センサの開発等、新たな製品・技術開発にも積極的に取り組んでまいりました。

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は3,687百万円となりました。経常損益は新事業の創出を加速させるために研究開発費を増加させる等一般管理費が増加した結果、84百万円の経常損失となりました。中間純損益は132百万円の中間純損失となり、投資有価証券の売却等に伴う特別利益を計上した前年同期から減少することとなりました。

### セグメント別業績

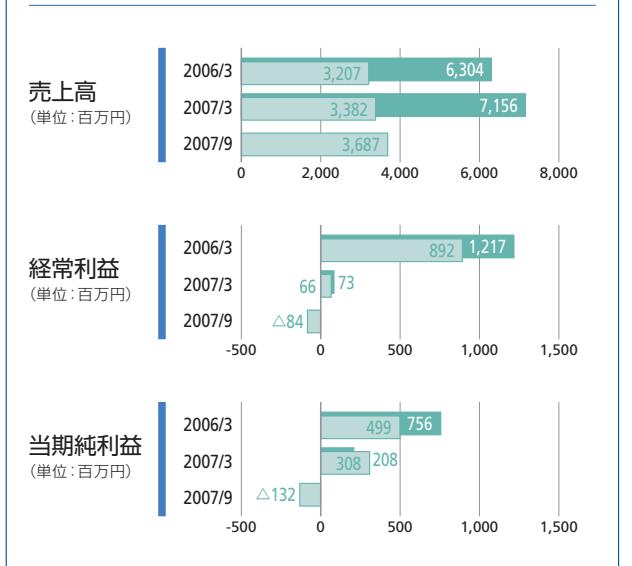
#### ■ 精機部門

光ディスク成形用金型を主力商品とする精機部門を取り巻く市場においては、薄型の高精細デジタルテレビの普及に追随するように、新型の次世代光ディスク録画・再生機が相次いで市場に登場しています。

しかしながら、ブルーレイ・ディスクとHD DVDの両陣営による次世代光ディスクの規格争いが続いているほか、録画・再生機の流通価格のさらなる下落に対する期待感から、消費者の多くは購入のタイミングを見極めており、本格的な購買活動に至っておりません。当社の金型のユーザーとなる光ディスク成形メーカー各社は、来るべき次世代光ディスク製造設備の増設に備えて投資を手控え、光ディスク成形用金型の新規販売は低調に推移いたしました。

これらの結果、当中間連結会計期間の精機部門の売上高は、850百万円（前年同期比18.0%減）となりました。

### 連結業績ハイライト



#### ■ 光製品部門

光通信用部品及びこれらの製造機器を主力商品とする光製品部門を取り巻く市場においては、インターネットの普及と相まって流通する情報量が拡大し、より高速で大容量通信に適した光通信網の整備が拡大しています。世界的な規模でFTTH（Fiber To The Home）化が進むなか、増加を続ける情報量に既存の光幹線網が追いつかず、海底ケーブルや大陸間を結ぶ長距離光幹線網の敷設需要も再燃しつつあります。

一方、そうした世界の光通信網の整備拡大を牽引してきた日本市場においては、光通信の導入に前向きな顕在需要が一巡したとみられ、その成長速度がやや鈍化し始めています。並行して、汎用的な光通信用部品の価格下落が一段と進むこととなりました。

これらの結果、当中間連結会計期間の光製品部門の売上高は2,837百万円（前年同期比21.0%増）となりました。



フォトニックデバイスグループ  
営業担当  
渡邊 育男

## 当社にとって未知の市場、半導体産業へのファーストステップ 炭化ケイ素単結晶研磨技術 (SiCウェハー研磨量産化技術)

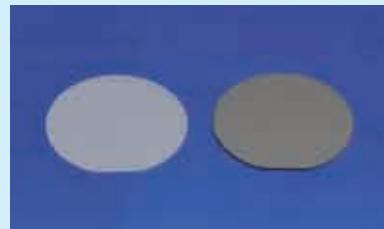
次世代半導体の基盤素材として注目される炭化ケイ素 (SiC) は、現在主流のシリコン (Si) に比べ、高電圧・高温に耐え、電力損失も少ない優れた特性が知られていました。しかしダイヤモンドに近い硬度をもつため研磨加工が難しく、量産化の妨げとなってきました。当社は、従来から保有している精密研磨技術に、独立行政法人 産業技術総合研究所様が公開している技術を導入し、この課題を解決、量産へ向けた体制を整えました。

**Q** 炭化ケイ素半導体は、どんな用途に使うのですか？  
精工技研の優位性はどこにありますか？

**A** 次世代半導体のベースとして、  
パワーエレクトロニクス技術を革新します。

炭化ケイ素の特性を活かし、高電圧・高電流を制御する電力・電源装置、通信システム、電車や自動車の駆動装置、太陽電池用半導体等への利用が期待されています。

炭化ケイ素は研磨中に電子的物性が損なわれやすく、従来は研磨に2~3日が必要で、量産化が難しいとされてきました。当社はこの作業の飛躍的な時間短縮と精度向上を実現しました。



当社技術で研磨された炭化ケイ素単結晶

**Q** 今後に向けて  
どのような事業展開が期待できますか？

**A** 半導体製造メーカーをパートナーとする  
ビジネス展開を期待しています。

この技術は今年10月のICSCRM2007\*で出展してから、すでに十数件の引き合いがありサンプル出荷をはじめています。この技術を通して、半導体産業という、当社がいままで参入していなかった新しい市場開拓に成功しつつあります。今後、周辺技術の成熟を待つ必要はありますが、炭化ケイ素単結晶の市場規模は2010年で数十億円、2020年には600億円前後と予測されており、先行者利益を活かして一定のシェアを確保したいと考えています。

\* International Conference on Silicon Carbide and Related Materials 2007



当社

他社

精工技研独自の技術とM&Aや技術提携等によって取得した技術。  
これらが融合し、いままで市場になかった新しい価値をもつ商品・技術開発が誕生しはじめています。  
今回はその中から3つをご紹介します。

## 光ファイバ設置工事の現場で活躍が期待される新商品 融着接続型光コネクタ (SOC:Splice-On Connector)

日本および北米で急速に普及が進む光通信。通信会社の局舎内や集合住宅に光ファイバを引き込む工事では、あらかじめ工場で接続用コネクタ付き光コードを生産しておき、現場でMDU (キャビネット) に接続する工法が一般的でした。しかしこの方法はコードの種類や長さが様々で在庫管理が煩雑になる他、工事現場で接続用コネクタが損傷しやすい、現場が狭小で接続用コネクタを通すことができない等、さまざまな問題を抱えていました。こうした課題を解決する方法として、当社が開発したSOCによる現場施工が注目を集めています。

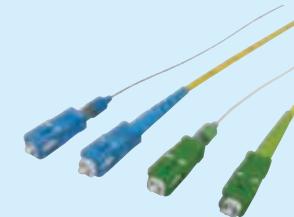
**Q** SOCはどのような点が評価されている  
商品なのですか？

**A** 光ケーブルとコネクタを  
現場で組み立てることができる画期的な商品です。

SOCは、光ファイバにフェルールユニットを融着接続することで、接続用コネクタを現場で短時間に、工場組み立てと同等の精度・性能で接続できる商品です。古河電気工業様と当社が共同で開発し、2007年4月より販売を開始。すでに北米の通信キャリア数社から製品認定を受けています。



スマートにパッケージされているSOC



現場で光コードに取り付けられたSOC



古河電気工業様の  
融着接続型光コネクタ用融着接続機



光製品グループ  
技術1チーム 技術1係 サブリーダー  
河崎 康成

**Q** どのような市場規模が想定されているのですか？

**A** 今後3年間で150万セットの販売を想定しています。

もともとSOCは、損傷した接続用コネクタの修理用として開発した商品でした。ところが、試作品完成後のマーケティング活動を通じ、「接続用コネクタの現場組み立て」という非常に大きなマーケットを探り当てることに成功しました。

現在、子会社である杭州精工技研有限公司に月産5,000セットの製造ラインを組んでいます。今年度中にラインを約10倍に増強。今後3年間で、北米向けを中心として150万セットの販売を見込んでいます。



第2開発グループ  
センサ開発チーム チームリーダー  
大沢 隆二

「光」で電波を計測! 電波暗室の光化を促進する新商品

## 光電界センサ

最近、話題に上ることの多い電子ノイズ対策。その計測には高い精度が求められますが、金属製アンテナとコードを使っている限り、常に計測誤差が入り込む危険性がつきまわっていました。この難しい課題を「光で電波を測る」ことで解決する画期的な新商品が、当社の光電界センサです。

**Q** 光電界センサとは、どんな機器ですか？

**A** 計測器の先に取り付けて、「光で電波を計測」する装置です。

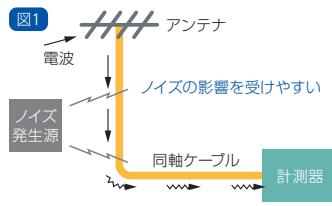
従来の電波計測器は、計測器本体と金属製のアンテナを同軸ケーブルで結ぶものが主流でした(図1)。このため、電波暗室(外の電波を通さない部屋)でも、余分な電波をケーブルが拾い、誤差が生じやすいという問題がありました。

当社の光電界センサ(図2)は、レーザ光を送って、光ファイバの先端に設けた光変調器(アンテナの機能を果たす)で電波を光信号に変換。光電界センサ内でふたたび電気信号に戻したものを計測器に引き渡す仕組みです。このため、余計な電波の影響を極限まで排した、極めて正確な電波計測が可能になります。

**Q** 光電界センサは、どのようなビジネスの広がりが期待できますか？

**A** 企業・大学が保有する電波暗室がメインターゲットです。

日本には現在、約1,000の電波暗室があるといわれています。モバイル機器や自動車用電子機器の増加につれ、より高度で精密な計測へのニーズは高まっており、大きな需要が期待されています。光電界センサはもともとNECトーキン様で開発した技術でした。同社の光デバイス事業を当社が譲り受け、当社が持つ光コネクタ周辺技術・ノウハウと出会い商品化が加速しました。現在も、様々な分野でシナジーを活かした製品開発が進んでいます。今後の当社にご期待ください。



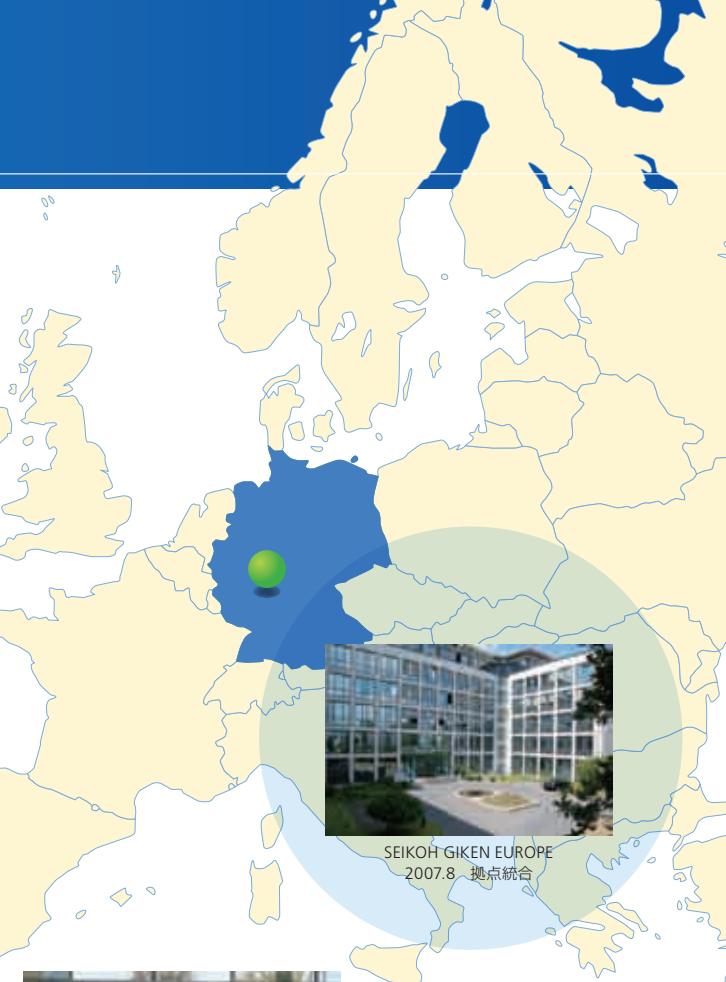
## SEIKOH GIKEN Europe GmbH 拠点紹介

2007年8月、SEIKOH GIKEN EUROPEは効率化と事業のシナジー創出を目的に、ドイツの商業・金融の中心地であるフランクフルトに本社を移転し、2ヶ所の拠点を統合しました。

光ディスク金型部品の販売やメンテナンスを行う営業拠点として、2002年5月、デュッセルドルフに設立したSEIKOH GIKEN EUROPE。設立以来、きめ細かなサポートで多くのお客様から高い信頼を獲得してまいりました。2005年9月には、セイコーインスツル様より光事業を譲り受け、欧州地域における光通信用部品の販売拠点としてフランクフルト支店を開設。積極的な販売プロモーションを展開し、現地に密着したビジネスを確立してまいりました。

現在の欧州市場は、次世代光ディスクの世界的な普及を前に、成形メーカー各社は光ディスクの量産用設備に対する投資のタイミングを計っています。また、FTTH用インフラの敷設が拡大しており、光通信関連市場も今後ますます大きなマーケットとして成長が期待されています。

今回、デュッセルドルフ(精機部門)とフランクフルト(光製品部門)の両拠点がひとつになることによって組織の効率化を図るとともに、両事業の情報やノウハウをお互いに活かして相乗効果を創出していきたいと考えています。欧州は、自動車・医療機器・モバイル製品等において先進的な発展を遂げている地域です。中でも大規模な国際空港を持つフランクフルトは、欧州全域に向けてダイナミックな事業展開を行う上で最適な立地条件を備えています。現地で収集した成長産業に関するホットな情報をいち早く当社グループ内で共有、将来の中核事業となる事業シーズを見つけるための戦略拠点としても重要な役割を担うSEIKOH GIKEN EUROPEに、今後ご期待ください。



SEIKOH GIKEN EUROPE  
2007.8 拠点統合



豊富な知識と経験を持つスタッフ



オフィスは、フランクフルト中心から10kmほど離れた街「ノイ・イーゼンブルク」

中間連結貸借対照表

科目	期別	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表
	当中間連結会計期間 平成19年 9月30日現在	前中間連結会計期間 平成18年 9月30日現在	前連結会計年度 平成19年 3月31日現在
<b>資産の部</b>			
流動資産	17,776	17,391	17,442
現金及び預金	13,731	13,427	13,399
受取手形及び売掛金	2,136	1,930	1,684
たな卸資産	1,536	1,556	1,743
未収法人税等	—	—	76
その他	381	482	546
貸倒引当金	△8	△5	△7
固定資産	8,179	8,816	8,771
有形固定資産	6,382	6,325	6,407
建物及び構築物	2,589	2,478	2,610
土地	2,211	2,211	2,211
その他	1,580	1,635	1,585
無形固定資産	639	812	728
のれん	491	649	570
その他	147	162	157
投資その他の資産	1,158	1,678	1,635
投資有価証券	27	75	30
その他	1,133	1,603	1,607
貸倒引当金	△1	△0	△1
資産合計	25,956	26,207	26,214

科目	期別	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表	前連結会計年度の 要約連結貸借対照表
	当中間連結会計期間 平成19年 9月30日現在	前中間連結会計期間 平成18年 9月30日現在	前連結会計年度 平成19年 3月31日現在
<b>負債の部</b>			
流動負債	1,194	1,154	1,117
買掛金	302	463	215
未払法人税等	37	164	34
その他	855	526	867
固定負債	598	561	585
退職給付引当金	255	232	243
長期末払金	149	138	148
その他	194	190	193
負債合計	1,793	1,715	1,703
<b>純資産の部</b>			
株主資本	23,918	24,488	24,388
資本金	6,791	6,791	6,791
資本剰余金	10,571	10,571	10,571
利益剰余金	6,925	7,435	7,335
自己株式	△370	△310	△309
評価・換算差額等	244	3	122
その他有価証券評価差額金	5	9	7
為替換算調整勘定	238	△5	114
純資産合計	24,162	24,491	24,510
負債、純資産合計	25,956	26,207	26,214

中間連結損益計算書

科目	期別	前連結会計年度の 要約連結損益計算書	前連結会計年度の 要約連結損益計算書
	当中間連結会計期間 平成19年4月1日から 平成19年9月30日まで	前中間連結会計期間 平成18年4月1日から 平成18年9月30日まで	前連結会計年度 平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで
売上高	3,687	3,382	7,156
売上原価	2,498	2,203	4,765
売上総利益	1,189	1,179	2,391
販売費及び一般管理費	1,315	1,174	2,465
営業利益又は営業損失(△)	△126	5	△74
営業外収益	90	72	170
営業外費用	48	11	22
経常利益又は経常損失(△)	△84	66	73
特別利益	0	405	405
特別損失	1	0	88
税金等調整前中間(当期) 純利益又は中間純損失(△)	△86	472	390
法人税、住民税及び事業税	32	155	168
法人税等調整額	13	7	13
中間(当期)純利益 又は中間純損失(△)	△132	308	208

中間連結キャッシュ・フロー計算書

科目	期別	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書	前連結会計年度の 要約連結キャッシュ・フロー計算書
	当中間連結会計期間 平成19年4月1日から 平成19年9月30日まで	前中間連結会計期間 平成18年4月1日から 平成18年9月30日まで	前連結会計年度 平成18年4月1日から 平成19年3月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	388	468	695
投資活動によるキャッシュ・フロー	△302	△557	△1,335
財務活動によるキャッシュ・フロー	△335	△361	△360
現金及び現金同等物に係る換算差額	26	2	24
現金及び現金同等物の減少額(△)	△222	△448	△975
現金及び現金同等物の期首残高	1,887	2,863	2,863
現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高	1,664	2,415	1,887

中間連結株主資本等変動計算書 (平成19年4月1日から平成19年9月30日)

	株 主 資 本					評価・換算 差額等合計	純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計		
平成19年3月31日残高	6,791	10,571	7,335	△309	24,388	122	24,510
中間連結会計期間中の変動額							
剰余金の配当			△276		△276		△276
中間純損失(△)			△132		△132		△132
自己株式の取得				△60	△60		△60
株主資本以外の項目の 中間連結会計期間中の変動額(純額)					—	121	121
中間連結会計期間中の変動額合計	—	—	△409	△60	△470	121	△348
平成19年9月30日残高	6,791	10,571	6,925	△370	23,918	244	24,162

## 株式の状況

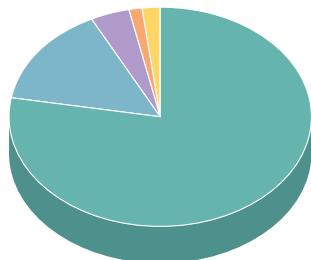
発行する株式の総数	37,000,000株
発行済株式総数	9,333,654株
株主数	4,546名

## 大株主

株主名	持株数(株)	議決権比率(%)
上野 昌利	912,000	9.9
都丸 由美子	890,500	9.7
細江 由紀子	882,500	9.6
(有)高志	694,000	7.5
(有)光研	623,000	6.8
木村 保	609,200	6.6
高橋 光雄	395,100	4.3
高橋 藤子	381,500	4.1
上野 淳	329,000	3.6
吉田 智恵	329,000	3.6

## 所有者別株式分布状況

個人・その他	78.0%
国内法人	14.7%
金融機関	4.2%
外国人	1.4%
その他	1.7%



## 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	毎年3月31日
株主名簿管理人	〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社
同事務取扱場所	〒105-8574 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 本店
同事務取扱所	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 ☎0120-78-2031
同 取 次 所	中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店

(お知らせ)住所変更、単元未満株式買取請求、名義書換請求および配当金振込指定に必要な各用紙のご請求は、下記株主名簿管理人中央三井信託銀行のフリーダイヤルまたはホームページをご利用ください。

- フリーダイヤル ☎0120-87-2031 (24時間受付：自動音声案内)
- ホームページ [http://www.chuomitsui.co.jp/person/p\\_06.html](http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html)

## 会社概要

商 号	株式会社 精工技研 (英文名)SEIKOH GIKEN Co., Ltd.
事 業 所	本社工場 千葉県松戸市松飛台296番地の1 第1工場 千葉県松戸市松飛台286番地の23 第2工場 千葉県松戸市松飛台296番地の1 第4工場 千葉県松戸市松飛台415番地の2 台湾支店 日商精工開発(股)台湾分公司 中華民国新竹市光復路2段285号
関連子会社	SEIKOH GIKEN USA, INC. 杭州精工技研有限公司 SEIKOH GIKEN EUROPE GmbH 大連精工技研有限公司 香港精工技研有限公司
創 業	1972年6月17日
資 本 金	6,791,682,700円
従 業 員	733名(子会社含む)

## 役員

取 締 役	代表取締役社長	上野 昌利*
	常務取締役	木村 保*
	取締役	吉田 泰昌*
	取締役	柳瀬 晴夫*
	取締役	大久保 勝彦
	*執行役員を兼務	
監 査 役	常勤監査役	宮永 剛
	監査役	三好 徹
	監査役	相場 俊夫
執行役員	執行役員	日置 政秀
	執行役員	石川 重太
	執行役員	住田 真
	執行役員	山崎 勇次郎
	執行役員	森 保彦

(注)1.取締役 大久保勝彦は社外取締役であります。  
2.監査役 三好徹、相場俊夫は社外監査役であります。

## 海外拠点



当社についての情報は、  
ホームページでもご覧いただけます。



<http://www.seikoh-giken.co.jp>



〈お問い合わせ先〉 経営企画室

〒270-2214 千葉県松戸市松飛台296番地の1  
TEL 047-388-6401(直通) FAX 047-311-5129  
E-mail [ir@seikoh-giken.co.jp](mailto:ir@seikoh-giken.co.jp)



本誌は、米国大豆協会認定の大豆油インキを使用しています。